



製品仕様表

シリーズ	Summit Pro SPシリーズ	
型式	SP30E	SP30ZE
印字レーザ	Yb：ファイバレーザ クラス4レーザ	
波長	1,064 nm	
最大出力	30 W	
印字方式	ガルバノスキャニング方式	ガルバノスキャニング方式（3D）
パルスレーザ周波数	5～200kHz	
印字範囲	<input type="checkbox"/> 65×65 mm	<input type="checkbox"/> 65×65×12 mm
	<input type="checkbox"/> 110×110 mm	<input type="checkbox"/> 110×110×32 mm
	<input type="checkbox"/> 290×290 mm	<input type="checkbox"/> 290×290×212 mm
ガイドレーザ・ポインタ	半導体赤色レーザ λ=655 nm クラス1レーザ	
ユーザ・インタフェース	レーザマーカアプリケーションPCソフトウェア	
ファイバケーブル長	5m	
電源電圧	AC100 ～ 120 V / AC200 ～ 230 V ± 10 %	
消費電力	最大420 VA / 平均220 W	
使用周囲温度	15～40 °C	
使用周囲湿度	10～80 %（結露なきこと）	
質量	ヘッド：約8 kg、コントローラ：約20 kg	



無料サンプル作成

印字対象ワークをお預かりし、
サンプル作成をさせて頂くと同時に
最適な機種を選定いたします。



専門家と相談

印字に関するご用命は、
弊社営業担当までご連絡ください。



世界中のサポート

世界中のネットワークで
お客さまをサポートさせていただきます。

製造元：
TELESIS TECHNOLOGIES, INC.
telesis.com

販売元：株式会社日立産機システム
<https://www.hitachi-ies.co.jp>



先進技術

Summit.Proは、ファイバレーザマーキング業界の先端をいくTELESISが提供する、先進的なマーキング技術です。

高品質

Summit.Proファイバレーザマーキングシステムは、TELESISの厳しい試験に耐える高品質で耐久性の高い部品で構成されています。

簡単設置

Summit.Proは、あらゆる生産ラインや製造設備に組込んでご使用いただけます。





PERFECTED BY TELESIS

ファイバレーザーマーキング

- ・生産ダウンタイム短縮
- ・コンパクトなサイズでスペースを取らず、生産工程への組込も容易
- ・取り外しできる豊富なレンズオプションにより高い柔軟性
- ・高品質なマーキングを実現
- ・作業品質の一貫性を向上
- ・硬質、高密度の材質にも深掘り印字実現
- ・消耗品をなくし、ランニングコストを削減
- ・消費電力を削減
- ・製品処理能力を向上



多彩な用途に 使用可能

ステンレス | ニッケル | カーバイド | 医療グレード合金 | 樹脂
タングステン | 銅 | アルミニウム | アルミニウム合金 | PVC | セラミック
鉄 | 特殊合金 : 黄銅 | 銀 | 金 | 青銅 | プラチナ



IMPROVE TRACEABILITY

鮮明な文字や2次元コード、そのほかの識別記号をあらゆる材質に高品質印字ができます。後処理で研磨しても印字がよみにくくなることはありません。レーザーマーカの最大の特徴は消えない印字です。



INTEGRATE WITH ROBOTICS

TELESISのすべてのレーザーは生産工程に組込可能で、Summit.Proシリーズも将来性を考慮して設計されています。組込についてご相談いただければ専門家が対応しますので、既存設備の生産性を最大限に達成することができます。



SHORTEN CYCLE TIMES

TELESISのレーザーマーキングシステムは、製造業務の効率を向上することによってサイクルタイムを短縮することができます。

HIGH POWER

鮮明な深掘りを実現。
複数の印字エリアとワーキングディスタンスが対応可能です。

製品寸法（単位：mm）
寸法は機種とレンズのオプションによって異なります。



オプション

VAR I ± Z ・ワーキングディスタンス可変幅：±106mm
(□290mm x 290mm レンズ)

	L	W	H
SP30E	515	127	117
SP30ZE	639	158	140

DESIGNED + BUILT
in THE UNITED STATES
